

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 4月21日
Date of Application:

出願番号 特願2003-115570
Application Number:

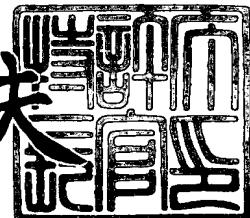
[ST. 10/C] : [JP2003-115570]

出願人 松下電器産業株式会社
Applicant(s):

2004年 3月 5日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 2913050142
【提出日】 平成15年 4月21日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G11B 7/135
【発明者】
【住所又は居所】 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 パナソニック
コミュニケーションズ株式会社内
【氏名】 國分 博希
【発明者】
【住所又は居所】 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 パナソニック
コミュニケーションズ株式会社内
【氏名】 杉本 剛
【発明者】
【住所又は居所】 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 パナソニック
コミュニケーションズ株式会社内
【氏名】 荒巻 正伸
【発明者】
【住所又は居所】 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 パナソニック
コミュニケーションズ株式会社内
【氏名】 森下 隆史
【特許出願人】
【識別番号】 000005821
【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100097445
【弁理士】
【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】**【識別番号】** 100103355**【弁理士】****【氏名又は名称】** 坂口 智康**【選任した代理人】****【識別番号】** 100109667**【弁理士】****【氏名又は名称】** 内藤 浩樹**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 011305**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ディスク装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 フレームと、前記フレームに固定された光ピックアップモジュールと、前記フレームに固定された制御回路を形成する回路基板を備え、前記フレームは樹脂を含む材料で構成され、前記フレーム重量は 13 g 以下であり、本体重量は 140 g 以下である事を特徴とする光ディスク装置。

【請求項 2】 樹脂材料は導電性の樹脂材料である事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 3】 フレームは複数の部材を厚み方向に積層して構成した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 4】 フレームは異なる材料で構成された複数の部材を平面状に並べ、結合して構成した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 5】 フレームは同一材料で構成された複数の部材を平面状に並べ、結合して構成した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 6】 フレームは一対の板状の樹脂板の間に金属板やセラミック板を挟み込んで構成した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 7】 フレームは樹脂中に板状片や線状の金属、セラミック材料等を分散させて構成した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 8】 フレームのディスク搭載側の面の、前記ディスク最大径の外側に隆起部を設けて前記フレームを補強した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 9】 フレームのディスク搭載側の面にディスク取り出し用の凹部を設けた事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 10】 フレームのディスク搭載側の面と略同一面上に配置される光ピックアップモジュールのカバーが、前記光ピックアップモジュール内のキャリッジの移動範囲に略対向する範囲で、隆起部を構成する事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置。

【請求項 11】 光ピックアップモジュールを構成する部材や部材の接合材、回

路基板を構成する電子部品や電子部品の接合材及び、その他フレームに搭載された部材や部材の接合材には鉛フリーの材質が使用されている事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、据え置き型のコンピュータなどの電子機器に好適に搭載され、特に好ましくは、モバイルコンピュータ（ノートブックパソコン等）、デジタルカメラ、電子手帳等のモバイル型電子機器に好適に搭載される光ディスク装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来のコンピュータ本体内蔵タイプの光ディスク装置は、装置全体が筐体に収められた構造になっており、これをコンピュータ本体のスペースに組み込むことによって取り付けられるのが一般的であった。取り付け部は筐体に有り、ここでコンピュータ本体に取り付けられていた。

【0003】

以下、従来の光ディスク装置の携帯用電子機器への取り付け方法について、図を参照して説明する。

【0004】

図8は従来の携帯用電子機器内蔵タイプの光ディスク装置の構成を示す斜視図である。1は光ピックアップ、2はメインシャフト、3はサブシャフト、4はスピンドルモータ、5はベース、6はピックアップモジュール（PUM）、7はトレイ、8はキャリッジ、9はレール、10は筐体、11は光ディスク装置、12は光ディスク装置側の取り付けネジ穴、13は制御回路等を構成する回路基板、14はフレームである（ディスク取り付け部の裏側から見る）。

【0005】

図9は従来の携帯用電子機器内蔵タイプの光ディスク装置11における携帯用電子機器への取り付け方法を示す図である。15は携帯用電子機器、16は取り

付けに介在させるアタッチメント、17はアタッチメント側取り付け穴である。

【0006】

図8において、光ピックアップ1はメインシャフト2、サブシャフト3をガイドとしてスピンドルモータ4の径方向に動きながらスピンドルモータ部に取り付けられたディスクのデーターの読み込みや書き込みを行なう。メインシャフト2、サブシャフト3はベース5に取り付けられ、全体としてピックアップモジュール6を形成する。ピックアップモジュール6はトレイ7に固定される。トレイ7はレール9によって筐体10に対してスライドするようになっている。トレイ7は、光ディスク着脱時には筐体10から引き出され、データの読み書き時には筐体10の中に収められる。また、制御回路等を構成する回路基板13はトレイまたは筐体の少なくとも一方に取り付けられている。以上の構成にて、全体として携帯用電子機器内蔵タイプの光ディスク装置11が形成されている。

【0007】

図9において、光ディスク装置本体11の筐体10にはコンピュータ本体へ取り付ける取り付けネジ穴12が設けられている。携帯用電子機器15には取り付けに介在させるアタッチメント16があり、アタッチメント側取り付け穴17と光ディスク装置側の取り付けネジ穴12間をネジ止めし、アタッチメント16を携帯用電子機器15に装着する事によって光ディスク装置を装着固定する。

【0008】

従来のディスク装置においては、筐体10は以上に示したように、ピックアップモジュール6やスピンドルモータ4等を装着したトレイ7をどうレール9を介して位置決めする働きとともに、光ディスクを携帯用電子機器15に固定する働きを有していた。光ディスク装置の薄型化も基本的にこの構造にて対応がなされていた。

【0009】

先行例としては、（特許文献1）（特許文献2）等がある。

【0010】

【特許文献1】

特開平8-171786号公報

【特許文献 2】

特開平7-201044号公報

【0011】**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、前記従来の構成では、ますます携帯用電子機器に薄型化や軽量化が求められる中、光ディスク装置自体の薄型化や軽量化が求められている。特に、光ディスク装置において軽量化の要求は高く、上記構成では、軽量化は非常に困難であった。

【0012】

本発明は、前記従来の課題を解決するもので、薄型化、特に軽量化を実現できる光ディスク装置を提供することを目的としている。

【0013】**【課題を解決するための手段】**

本発明は、フレームと、前記フレームに固定された光ピックアップモジュールと、前記フレームに固定された制御回路を形成する回路基板を備え、前記フレームは樹脂を含む材料で構成され、前記フレーム重量は13g以下であり、本体重量は140g以下とした。

【0014】

これにより、筐体を使用する事無しに光ディスク装置の構成部品を固定する事が出来、またフレームが大幅に薄型、軽量になる事により、光ディスク装置の大変な薄型化、軽量化及び電子機器本体の薄型化、軽量化が達成される。

【0015】**【発明の実施の形態】**

請求項1記載の発明は、フレームと、前記フレームに固定された光ピックアップモジュールと、前記フレームに固定された制御回路を形成する回路基板を備え、前記フレームは樹脂を含む材料で構成され、前記フレーム重量は13g以下であり、本体重量は140g以下である事を特徴とする光ディスク装置によって、従来必要であった筐体を設けなくても良く、装置として薄型化、軽量化を実現できる。

【0016】

請求項2記載の発明は、樹脂材料は導電性の樹脂材料である事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置によって、よりノイズに強い光ディスク装置を提供出来る。

【0017】

請求項3記載の発明は、フレームは複数の部材を厚み方向に積層して構成した事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置によって、フレームが強固で軽量となる為、より薄型、軽量な光ディスク装置を提供出来る。

【0018】

請求項4記載の発明は、フレームは異なる材料で構成された複数の部材を平面状に並べ、結合して構成した事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置によって、フレームを各部分に分割し各部分で最適な部材で構成できる為、フレームが強固で軽量となり、さらに薄型、軽量な光ディスク装置を提供出来る。

【0019】

請求項5記載の発明は、フレームは同一材料で構成された複数の部材を平面状に並べ、結合して構成した事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置によって、フレームの形状設計の自由度が増す為、さらに薄型、軽量な光ディスク装置を提供出来る。

【0020】

請求項6記載の発明は、フレームは一対の板状の樹脂板の間に金属板やセラミック板を挟み込んで構成した事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置によって、フレームをより強化する事が出来る為、さらに薄型、軽量な光ディスク装置を提供出来る。

【0021】

請求項7記載の発明は、フレームは樹脂中に板状片や線状の金属、セラミック材料等を分散させて構成した事を特徴とする請求項1記載の光ディスク装置によって、フレームをより強化する事が出来る為、さらに薄型、軽量な光ディスク装置を提供出来る。

【0022】

請求項 8 記載の発明は、フレームのディスク搭載側の面の、前記ディスク最大径の外側に隆起部を設けて前記フレームを補強した事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置によって、強固で軽量なフレームにする事が出来、薄型、軽量な光ディスク装置を提供する事が出来る。

【0023】

請求項 9 記載の発明は、フレームのディスク搭載側の面にディスク取り出し用の凹部を設けた事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置によって、光ディスク使用時のディスク着脱作業をより容易にする事が出来る。

【0024】

請求項 10 記載の発明は、フレームのディスク搭載側の面と略同一面上に配置される光ピックアップモジュールのカバーが、光ピックアップモジュール内のキャリッジの移動範囲に略対向する範囲で、隆起部を構成する事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置によって、カバーの強度が増す事により厚みを薄く出来、軽量化が可能となる。よって、より薄型、軽量な光ディスク装置を提供する事が出来る。

【0025】

請求項 11 記載の発明は、光ピックアップモジュールを構成する部材や部材の接合材、回路基板を構成する電子部品や電子部品の接合材及び、その他フレームに搭載された部材や部材の接合材には鉛フリーの材質が使用されている事を特徴とする請求項 1 記載の光ディスク装置によって、装置として鉛フリーの製品を提供する事が出来る。

【0026】

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。

【0027】

図 1 は本発明の一実施の形態における光ディスク装置を表面から見た斜視図、図 2 は本発明の一実施の形態における光ディスク装置をカバー及び結線手段を除去し裏面から見た斜視図である(図 2 ではカバー、フラットケーブルを省略している)。また、図 3 は本発明の一実施の形態における光ディスク装置の光学系の構成を示す図、図 4 は本発明の一実施の形態における光ディスク装置を裏面から

見た斜視図、図5は本発明の一実施の形態における光ディスク装置の正面図、図6は本発明の一実施の形態における光ディスク装置の他の取り付け方法を示す図、図7は本発明の一実施の形態における光ディスク装置のドライブイジектスイッチの配置の例を示す図である。

【0028】

図1、図2において、18は各部を保持するフレームで、フレーム18の構成材料は、変性ポリフェニレンオキサイド、ABS樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂とポリカーボネート混合物、ポリブチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン、液晶ポリマー、ポリフェニレンサルファイド、ポリスチレン、ポリアセタール、ポリアミド等の樹脂材あるいは前記樹脂材料にガラスやアルミナなど無機物を添加した樹脂材料あるいは導電性を有する樹脂材料にて構成されている。特に変性ポリフェニレンオキサイドもしくは変性ポリフェニレンオキサイドと無機物纖維もしくは粉体との混合物がフレーム18の材料としては好ましく、これら材料を用いる事で剛性を高め、反り防止を実現できるとともに、軽量化を更に進めることができる。

【0029】

なお、本実施の形態では、フレーム18は一種類の樹脂材料で全て一体に構成したが、部分的に他の材料を用いたり、あるいは異なる材料で構成された複数の部材を平面状に並べ、それら部材間を機械的に結合させたり、接着剤などで接着したりしてフレーム18を構成しても良く、更には、同一材料で構成された部材を上述の通り、互いに結合させてフレーム18を構成しても良い。

【0030】

更に、フレーム18は、複数の部材（同一材料あるいは異なる材料）を厚み方向に積層して接着などの手法を用いて積層しても良い。例えば、一対の板状の樹脂板の間に剛性が大きな金属板やセラミック板を挟み込んでフレーム18を構成しても良い。

【0031】

また、フレーム18を樹脂を主体として構成した場合に、その樹脂中に板状片や線状の金属あるいはセラミック材料等の剛性を大きくすることが可能な部材を

分散させて、フレーム 18 自体を軽量化させつつ剛性を大きくすることもできる。

【0032】

以上のようにフレーム 18 は上述した構成としたり、あるいは上述の構成を組み合わせることで、剛性や軽量化を実現させている。

【0033】

フレーム 18 には貫通孔 18 a があり、ピックアップモジュール 19 が挿入されている。フレーム 18 には、裏面 18 d から表面 18 b に向かって表面 18 b から隆起した隆起部 18 c が設けられている。ピックアップモジュール 19 は貫通孔 18 a に裏面 18 d から挿入されているが、隆起部 18 c はピックアップモジュール 19 の端部を覆い、かつディスク装着されるディスク径の最大径の外側に設けられている。これにより、ディスク装着時にディスクに干渉すること無くフレーム 18 の貫通孔 18 a の外周の一部に厚みを持たせ、強化する事が出来る。具体的には図 1 に示すように隆起部 18 c の側部 18 e の厚み L 1 を隆起部 18 c 近傍の側部 18 f の厚み L 2 よりも厚くし、機械的強度を増す事が出来る。隆起部 18 c の側部 18 e は天部 18 g と一体に設けられている。すなわち、隆起部 18 c は少なくとも側部 18 e と天部 18 g で構成されている。また、側部 18 e の厚み L 1 は天部 18 g の厚み L 3 よりも厚い。また、隆起部 18 c を構成する側部 18 e の半分以上を近傍の側部 18 f の厚み L 2 よりも厚くする事が機械的強度を強化する為には望ましい。また、天部 18 g の内端部 18 h は円弧状となっていて、貫通孔 18 a の一部を構成している。天部 18 g には 1 つもしくは複数個の貫通孔 18 i が軽量化の為に設けられている。また、フレーム 18 を構成する場合、生産性などを考慮すると貫通孔 18 i は設けない場合、構造が簡単になり、フレーム 18 を作製が容易となるので、生産性を向上させたい場合には、貫通孔 18 i を設けない構成とすることが好ましい。

【0034】

また、フレーム 18 の表面 18 b には取り付けたディスクを取り外す際に指をディスクとフレーム 18 の間に入れやすくするディスク取出し用窓み 18 j が設けられている。ディスク取出し用窓み 18 j の範囲はスピンドルモータ 19 e の

軸中心から径方向Dで22mm～55mm、円周方向で12mm～26mm深さは1mm～2.5mmに設定されている。これによって小径タイプのディスクの取り出し作業を容易にすることができます。

【0035】

このように構成されたフレーム18では、強度を保ちつつ重量を15g以下に抑えることが可能となり、光ディスク装置を軽量化することができる。

【0036】

ピックアップモジュール19には枠状のフレーム19aと上面に取付けられたカバー19bが設けられている。カバー19bには貫通孔19cが設けられている。スピンドルモータ19eは底板19dを介してネジなどでフレーム19aに取付けられている。スピンドルモータ19eのディスクが装着される部分はカバー19bの貫通孔19cからフレーム19aの表面18b側に突出している。

【0037】

キャリッジ20はフレーム19aに固定された略平行な2本のシャフト19f, 19gに移動自在に保持されている。

【0038】

モータ21はフレーム19aに固定されており、ギヤ群21aを介してフレーム19aに回転自在に取付けられた回転シャフト21bを回転させる。回転シャフト21bはシャフト19の近傍に設けられており、シャフト19に略平行に取付けられている。しかも回転シャフト21bはシャフト19fに対してシャフト19gと反対側に設けられている。回転シャフト21bにはスパイラル状の溝が設けられており、キャリッジ20に設けられたガイド20aと嵌合している。回転シャフト21bの回転により、ガイド20a及びキャリッジ20はシャフト19f, 19gに沿って双方（図1に示す矢印A）に移動する。以上のようにキャリッジ20を移動させる手段としてのモータ21, 回転シャフト21b, ギヤ群21aはシャフト19fに対して19gと反対側にまとめて収納されている。

【0039】

ピックアップモジュール19にあるカバー19bにおいて、キャリッジ20が移動する範囲に略対向する範囲は、キャリッジ20が移動する範囲に略対向しな

い範囲に対してキャリッジ20から離れる向きに隆起しており、隆起部19hが形成されている。隆起部19hの高さはキャリッジ20の移動範囲においてキャリッジ20と干渉しないよう設定されている。これによってカバー19bの隆起部19hとそれ以外の部分との間に段差が生じカバー19bが強化されるため、カバー19bの厚みを薄くしても、強度の低下を最小限に食い止める事が出来る。

【0040】

キャリッジ20には金属材料のダイキャスト等によって構成されたフレーム20bが設けられており、フレーム20bにはディスクの読み取りや書き込みを行なう光学系が搭載されている。図3にフレーム20bに搭載された光学系の構成について説明する。

【0041】

波長が677nm以下のレーザ光を発するDVD用半導体レーザ20bから発せられたDVD用レーザ光は、反射ミラー20cで反射して光路を変えた後、コリメートレンズ20dに入って平行光となる。平行光となったレーザ光はプリズム20eを透過し、立ち上げプリズム20fで光路を変え、 $1/4\lambda$ 板20gを通過後対物レンズ20hで収束して、ディスク20iに照射する。ディスク20iからの反射光は対物レンズ20h、 $1/4\lambda$ 板20gを通過して立ち上げプリズム20f、プリズム20eで向きを変え、コリメートレンズ20jで収束して積層プリズム20kに入射し向きを変えて、センサ20lに入射する。

【0042】

一方、波長が765nmから795nmのレーザ光を発するCD用半導体レーザ20mから発せられたCD用レーザ光は、積層プリズム20kを通過しコリメートレンズ20jに入って平行光になりプリズム20eに入射する。プリズム20e、立ち上げプリズム20fで向きを変え、 $1/4\lambda$ 板20gを通過し対物レンズ20hで収束して、ディスク20iに照射する。ディスク20iからの反射光は対物レンズ20h、 $1/4\lambda$ 板20gを通過して立ち上げプリズム20f、プリズム20eで向きを変え、レンズ20iで収束して積層プリズム20kに入射し向きを変えて、センサ20lに入射する。

【0043】

立ち上げプリズム20f、1/4λ板20g、対物レンズ20hはアクチュエータ22上に構成されている。アクチュエータ22はダンパー22aを介してキャリッジ20に取り付けられている。また、アクチュエータ22には、アクチュエータコイル22bが構成されている。レーザ光のディスク上の動きに対してアクチュエータコイル22bが動的に補正をかけてアクチュエータ22を動かし、対物レンズ20hを動かして、レーザ光の位置を補正する。

【0044】

対物レンズ20hはフレームの表面18b側を向いており、全可動範囲は貫通孔19cの範囲内に存在している。

【0045】

ピックアップモジュール19の枠状のフレーム19aには取り付け部19iが設けられており、防振用ダンパー19jを介してフレーム18に固定されている。防振用ダンパー19jは弾性材料で構成されており、具体的にはブチルゴムやシリコンゴムが用いられる。取り付け部19iは少なくとも3個所以上略等間隔に設けられている。特に取り付け部19iの少なくとも1個所をスピンドルモータ19eの近傍に設けることは、スピンドルモータ19eの振動を防振する上で効果的である。

【0046】

回路基板は第1の回路基板23と第2の回路基板24に分割されており、第1の回路基板23は多角形の形状を、第2の回路基板24は円弧状の切り欠き24aのある多角形の形状をしている。第1の回路基板23は、主にディスクに読み書きを行なうレーザ光の信号制御を行なう回路を構成している。第2の回路基板24は、主にスピンドルモータ19eやキャリッジ20を動かすモータ21やアクチュエータ22の制御を行なう回路を構成している。

【0047】

更に、第1の回路基板23及び第2の回路基板24は、それぞれフレーム18のディスクが装着される側と反対側の裏面18dに固定されており、しかもスピンドルモータ19eと対物レンズ20hを結んだ直線を境界に左右にそれぞれ設

けられている。この様に光ディスク装置を制御する回路基板を2分割して、フレーム18に固定することで、光ディスク装置の形状すなわち、フレーム18の形状を、光ディスク装置を搭載する電子機器に適した任意の形状とすることができます、電子機器への装着性を向上させることができます。

【0048】

なお、本実施の形態では、回路基板を2分割したが、3分割以上とすることもできる。

【0049】

第1の回路基板23は、フレーム18の裏面18d側にピックアップモジュール19に隣接し、スピンドルモータ19eに対してシャフト19f側に取り付けられている。第1の回路基板23の端辺には複数の切り欠き状の係止部23dがあり、フレーム18の端辺に設けられた複数個のかぎ状の係止部18kと係止し、さらにネジ止め部をネジ止めすることで、フレーム18に固定される。係止部18kはフレーム18に一体に構成されているが、同一材料あるいは異なる材料の別部材で係止部18kもしくは係止部18kを含む部分を構成し、フレーム18の所定の位置にネジ止めや溶着や形状的な嵌合で機械的に結合させたり、接着剤などで接着して取り付けても良い。第1の回路基板23には2個のコネクタ23a, 23bが取り付けられており、コネクタの長辺はそれぞれ第1の回路基板23の各辺に略並行に配置されている。コネクタ23a, 23bのケーブル挿入部はいずれも基板の外側を向いている。また、コネクタ23bの長辺は、第1の回路基板23のピックアップモジュール19に対面する一辺23cに略並行して取り付けられている。

【0050】

第2の回路基板24は、フレーム18の裏面18d側にピックアップモジュール19に隣接し、スピンドルモータ19eに対してシャフト19g側に取り付けられている。また、第2の回路基板24はフレーム18の端辺にある複数個のかぎ状の係止部18lで係止し、さらにネジ止め部をネジ止めすることで、フレーム18に固定される。係止部18lはフレーム18に一体に構成されているが、同一材料あるいは異なる材料の別部材で係止部18lもしくは係止部18lを含

む部分を構成し、フレーム 18 の所定の位置にネジ止めや溶着や形状的な嵌合で機械的に結合させたり、接着剤などで接着して取り付けても良い。

【0051】

第2の回路基板 24 には4個のコネクタ 24b, 24c, 24d, 24e が取り付けられており、コネクタ 24b, 24c の長辺はそれぞれ第2の回路基板 24 の各辺に略並行に配置されている。また、コネクタ 24b の長辺は、第2の回路基板 24 のピックアップモジュール 19 に対面する一辺 24f に略並行して取り付けられている。コネクタ 24b のケーブル挿入部は基板の内側を向いており、コネクタ 24c のケーブル挿入部は基板の外側を向いている。コネクタ 24b はコネクタ 24d は例えばフラットケーブルやフレキシブル基板などの結線手段（図示せず）を介してキャリッジ 20 に接続されている。コネクタ 24d は例えばフラットケーブルやフレキシブル基板などの結線手段（図示せず）を介してキャリッジ 20 を動かすモータ 21 に接続されている。コネクタ 24e は第2の回路基板 24 の裏面（コネクタ 24b, 24c, 24d が配置されている面とは反対の面）に配置されており、フラットケーブルやフレキシブル基板などの結線手段（図示せず）を介してスピンドルモータ 19e に接続されている。

【0052】

なお、第1の回路基板 23 の回路と第2の回路基板 24 の回路を1つの基板上に構成し、回路基板を1つにすることも可能である。この場合基板間を結線する結線手段は不要となるので、より安価な構成にすることができる。

【0053】

また、回路基板を1つもしくは複数の基板とし、これらをディスクの直径内または直径内近傍に収めることも可能である。この場合、ディスクを載せた光ディスク装置の正面から見た面積は最小にすることができる。

【0054】

ソレノイド 25 はディスクのイジェクト動作に関与するもので、第1の回路基板 23 とピックアップモジュール 19 に挟まれてフレーム 18 の裏面 18d 側に固定されている。

【0055】

フレーム 18 の裏面 18 d 側にはピックアップモジュール 19 及び第 2 の回路基板 24 を覆ってカバー 26 が取り付けられている。第 2 の回路基板 24 をシールドする方法が別途あるならば、カバー 26 が第 2 の回路基板 24 をシールドする必要はない。カバー 26 をフレーム 18 に固定しているカバー固定部 26 a の一部は、第 1 の回路基板 23 及び第 2 の回路基板 24 の接地部と直接接触またはバネを介して接触しており、ネジ止めによってカバー 26 の固定と接地、さらに回路基板 23 及び第 2 の回路基板 24 の固定をおこなっている。

【0056】

カバー 26 にはピックアップモジュール 19 を構成する部品の一部との干渉を回避するため、または軽量化の為に複数の貫通孔 26 b が設けられているが、特に軽量化の必要がない場合は軽量化のための貫通孔は省略できる。またカバー 26 には第 2 の回路基板 24 に略対向する範囲において、第 2 の回路基板 24 から離れる向きに押し出された突出部分 26 c が設けられている。突出部分 26 c は第 2 の回路基板 24 上のコネクタ 24 b を覆っている。

【0057】

第 1 の回路基板 23 と第 2 の回路基板 24 とは第 1 の回路基板 23 上のコネクタ 23 b と第 2 の回路基板 24 上のコネクタ 24 b に接続された結線手段 27 にて結線されている。結線手段 27 はカバー 26 を少なくとも一部を覆うように配置されている。結線手段 27 は光ディスク装置の薄型化のためにはフラットケーブルやフレキシブル基板など平帯状のものが望ましい。第 2 の回路基板 24 上のコネクタ 24 b に結線された結線手段 27 は、コネクタ 24 b の近傍でカバー 26 の端部を迂回するよう折返されてカバー 26 を覆う位置に引き出される。第 1 の回路基板 23 上のコネクタ 23 b と第 2 の回路基板 24 上のコネクタ 24 b の位置関係から直線状の結線手段が使用できない場合、コネクタ位置関係に相応して湾曲した結線手段を用いることで光ディスク装置の薄型化を妨げずに結線ができる。また、直線状で平帯状の結線手段 27 に折り曲げ部 27 a を設けることで、安価な直線状の結線手段にて第 1 の回路基板 23 上のコネクタ 23 b と第 2 の回路基板 24 上のコネクタ 24 b の位置関係に対応可能となる。折り曲げ部 27 a はコネクタ 23 b の長辺の垂直二等分線 B とコネクタ 24 b の長辺の垂直二等

分線Cの少なくとも一方の近傍に設けられることで、平帯状の結線手段の表面のねじれや浮き上がりを低減することができる。さらに折り曲げ部27aについては偶数回折り曲げることによって、平帯状の結線手段27の両端のコネクタとの接触部分が平帯状のフラット面の同じ側に来る為、ケーブルとの接触部分が片面である多くのフラットケーブル用コネクタに使用可能となる。例えば図4は2回折り曲げの例で、第1の回路基板23上のコネクタ23bから出た平帯状の結線手段27は、折り曲げ部27aで折り曲げられて一度コネクタ23bの長辺の垂直二等分線Bに対してコネクタ24bとは反対側に引き出され、再び折り曲げ部27aで折り曲げられてコネクタ24b側に引き出される。

【0058】

平帯状の結線手段27をカバー26に固定するために固定手段27bが用いられる。固定手段27bとしては粘着性を有するテープを用いて結線手段27をカバー26に固定する方法や、固定手段27bとして可撓性を有する部材をカバーに間隔をあけて接合し、その接合部間に結線手段27を通して、着脱自在に固定する方法が好ましい。また、結線手段27とカバー26の間に両面テープを挟んで接着することも可能である。

【0059】

フレーム18の第1の回路基板23に対向する部分の近傍には貫通孔18mが設けられており、第1の回路基板23に配置された押しボタンスイッチ23fが、貫通孔18mを貫通してフレーム18の表面18bから突出している。押しボタンスイッチ23fの押しボタン23gの可動方向は、回路基板23の面に対して略垂直である。貫通孔18mは併せてフレーム18の軽量化の目的もある為、必要となる軽量化度合いを含めて貫通孔18mの寸法が決められる。

【0060】

なお、押しボタンスイッチ23fは携帯用電子機器側に取り付けられた開閉可能なカバーの開閉状況を検知するものであるが、検知した信号を携帯用電子機器側に送ることも可能である。また、押しボタンスイッチ23fはフレーム18の表面18b上に設けることも可能である。

【0061】

また、フレーム18には別の貫通孔18nがあって、フレーム18の表面18b側から見たときソレノイド25の一部を露出させている。

【0062】

また、フレーム18の表面18bには必要に応じてディスクの回転を止めるブレーキ28が設けられている。ブレーキ28はケース28aと可動部28bとパット28cとバネ28dにより構成されている。ケース28aはフレーム18と一緒に成型されているが、フレーム18と同一材料あるいは異なる材料の別部材で構成し、フレーム18の所定の位置に取り付けても良い。図5で可動部28bの移動軸28eはスピンドルモータ19eの回転中心を通り、またケース28aで可動範囲が規制されている。バネ28dは可動部28bをスピンドルモータ19eの径方向中心に向かって押し出すように設定されている。パット28cは可動部28bのスピンドルモータ19eの径方向中心に向かう面に設けられており、シリコンゴム、フェルトなどディスクの材料との摩擦係数が高い材質にて構成されている。パット28cのディスクに接する面は、移動軸28eの垂直面に対しディスクに平行な面上で角度θの傾きを有する。これにより、ディスクの外形のばらつきがあっても、パット28cがディスクに接している際のバネ28dの収縮量は一定になり、パット28cのディスクへの押圧力は一定になる。具体的には想定されているディスクの外形のばらつき幅は0.3mmから0.6mmである。想定されたディスク径のばらつき幅に対応できるよう、パット28cのディスクに接する面の傾き量θと幅Gが設定されている。可動部28bとパット28cの可動範囲は、スピンドルモータ19eの中心からパット28c表面中心までの距離Fで58.5mmから61.5mmに設定されており、Gは4mmから10mmに設定されている。また、バネ28dは直径120mmのディスクが装着され、ブレーキの為パット28cが当たった際、パット28cからディスクに所定の加重（例えば10g重程度）の押圧力がかかるように設定されている。このような設定にすることで、直径120mmのディスクの回転を十分に止めることができる。さらにパット28cのディスクに接する面の、ディスク厚み方向の寸法Hは4mmから10mmに設定されている。これによって、ディスク装着時のディスクの厚み方向のガタやディスクの規定内の反りを含めて、ディスク停止

時はディスクの側面を確実にパット 28c に当てることができる。可動部 28b には傾斜面 28f が設けられており、外部からの押し出し棒が傾斜面 28f を押すことにより、可動部 28b のスピンドルモータ 19e の径方向の動きが得られる。具体的には、携帯用電子機器のディスク取り出し用可動ディスクカバーに押し出し棒を設け、可動ディスクカバーを閉じる事により押し出し棒が傾斜面 28f を押し、可動部 28b がディスク 28g から離れてブレーキを解除する。

【0063】

フレーム 18 の外形はピックアップモジュール 19、第 1 の回路基板 23、第 2 の回路基板 24 を保持できる形状、例えばピックアップモジュール 19 の外周を囲み、第 1 の回路基板 23 と第 2 の回路基板 24 を覆い保持部を取り付ける事が出来る形状に設定される。

【0064】

光ディスク装置固定部 29 は、フレーム 18 の側部 18e または側部 18f から突出して、またはフレーム 18 の側部からフレーム 18 の内側に入り込んであるいはフレーム 18 の面内に設けられている。

【0065】

光ディスク装置固定部 29 はフレーム 18 に一体に設けられているが、同一材料あるいは異なる材料の別部材で光ディスク装置固定部 29 もしくは光ディスク装置固定部 29 を含む部分を構成し、フレーム 18 の所定の位置にネジ止めや溶着や形状的な嵌合で機械的に結合させたり、接着剤などで接着して取り付けても良い。

【0066】

また、光ディスク装置固定部 29 は 2～10 個程度設けることが好ましく、特に好ましくは 4 個～8 個程度設けることが好ましい。光ディスク装置固定部 29 が 1 個では十分な強度での取り付けは困難であり、10 個より多いと取り付けに時間が掛かってしまい、生産性が低下する可能性がある。

【0067】

例えばフレーム 18 の外周でネジをフレーム 18 の表面 18b に略垂直に立ててネジ止めする場合は、光ディスク装置固定部 29 の形状は、図 2 の D 部に示す

ように、フレーム18の側部18eまたは側部18fからフレーム18の表面18bに略平行して突出したランド29aと、ネジを通す為のフレーム18の面に略垂直な孔29bで構成される。もしくは図2のE部に示すように、フレーム18の側部18eまたは側部18fからフレーム18の表面18bに略平行して入り込んだランド29cとネジを通す為のフレーム18の面に略垂直な孔29dで構成される。また、光ディスク装置固定部29の形状は図2のD部に示す形状をフレーム18の表面18bに略垂直に突出した平板とし、ネジ孔は突出させた平板に略垂直に設けて、ネジの方向をフレーム18の表面18bに平行にして相対する携帯用電子機器の固定部に取り付けることも可能である。

【0068】

また、光ディスク装置固定部29の形状は熱溶着もしくは超音波溶着が可能な接合部を有し、熱溶着もしくは超音波溶着によって光ディスク装置を携帯用電子機器に固定することも可能である。

【0069】

また、他の光ディスク装置と携帯用電子機器の固定方法として、光ディスク装置及び携帯用電子機器の双方に接着剤による固定が可能な形状（好ましくは平坦部を有した固定部）を設置し、少なくとも一部に接着剤による固定または接着材と他の結合手段の併用にて固定する方法も可能である。この場合、接着剤を使用する事によって、ネジ止め等困難な場所においても光ディスク装置の固定が可能となり、設計の自由度が増加する。

【0070】

また、他の光ディスク装置と携帯用電子機器の固定方法として、図6は本発明の実施の形態における光ディスク装置の他の取り付け方法を示す図である。光ディスク装置のフレーム18には、光ディスク装置固定部29が設けられており、ネジ止めあるいは溶着による固定あるいは接着剤による固定がなされており、また他に1つもしくは複数個の係止用の爪30が設けられている。また携帯用電子機器15内面には、係止用の爪30との係止部31が設けられている。これらによつて、光ディスク装置11のフレーム18の係止用の爪30と携帯用電子機器15内面の係止部31を係止後、光ディスク装置固定部29にて固定することで

、光ディスク装置11は携帯用情報端末15の内側底面に固定される。本取り付け方法では、一部嵌合用爪を使用する事によってネジ止め個所を削減する事が可能となり、組み立て可能性を改善する事が出来る。

【0071】

また、図7は本実施の形態におけるドライブイ杰クトスイッチの配置の例を示す図である。ディスクを取り出す為には、携帯用電子機器15に設けられたドライブイ杰クトスイッチ32を操作する。これによってコンピュータ本体に設けられた可動ディスクカバー33を開くとともに、実行中のアプリケーションを終了させたり、スピンドルモータを停止させるなどの制御動作を行なう。従来の技術では、ドライブイ杰クトスイッチは光ディスク装置側に設けられていたが、このようにドライブイ杰クトスイッチを光ディスク装置上でなく、携帯用電子機器本体に取り付けることによって、ドライブイ杰クトスイッチを保持する機構を光ディスク装置側から省略する事が出来る為小型化でき、コンピュータ全体も小型化する事ができる。

【0072】

以上のように構成された光ディスク装置では、従来のような筐体10にて各部材を取り付け、携帯用電子機器に取り付ける構成ではなく、フレーム18に各部材を取り付けフレーム18を直接携帯用電子機器にネジ止めなどで取りつける方式なので、筐体10が不要となり、従来の光ディスク装置を取り付けた携帯用電子機器よりもより薄型、軽量の携帯用電子機器を提供する事が出来る。

【0073】

なお、本実施の形態の光ディスク装置は携帯用電子機器のみでなく固定用電子機器にも取り付け可能である。

【0074】

以上のような一例に示すような光ディスク装置は135g以下（好ましくは120g以下さらに好ましくは100g以下）が実現可能となり、このような光ディスク装置を電子機器に搭載する事により、電子機器自体を小型化する事が出来る。

【0075】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置では、110mmから130mmまでの直径のディスクが装着可能な構成において特に有用である。

【0076】

【発明の効果】

以上のように本発明は、フレームと、フレームに固定された光ピックアップモジュールと、フレームに固定された制御回路を形成する回路基板を備え、フレームに他の部材への取り付け部を設けたことで、筐体が不要となり、装置として薄型化、軽量化を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置を表面から見た斜視図

【図2】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置をカバー及び結線手段を除去し裏面から見た斜視図

【図3】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置の光学系の構成を示す図

【図4】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置を裏面から見た斜視図

【図5】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置の正面図

【図6】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置の他の取り付け方法を示す図

【図7】

本発明の一実施の形態における光ディスク装置のドライブイジェクトスイッチの配置の例を示す図

【図8】

従来の携帯用電子機器内蔵タイプの光ディスク装置の構成を示す斜視図

【図9】

従来の携帯用電子機器内蔵タイプの光ディスク装置における携帯用電子機器へ

の取り付け方法を示す図

【符号の説明】

- 1 光ピックアップ
- 2 メインシャフト
- 3 サブシャフト
- 4 スピンドルモータ
- 5 ベース
- 6 ピックアップモジュール
- 7 トレイ
- 8 キャリッジ
- 9 レール
- 10 筐体
- 11 光ディスク装置
- 12 光ディスク装置側の取り付けネジ穴
- 13 制御回路等を構成する回路基板
- 14 フレーム
- 15 携帯用電子機器
- 16 アタッチメント
- 17 アタッチメント側取り付け穴
- 18 各部を保持するフレーム
 - 18 a 貫通孔
 - 18 b 表面
 - 18 c 隆起部
 - 18 d 裏面
 - 18 e 側部
 - 18 f 隆起部近傍の側部
 - 18 g 天部
 - 18 h 内端部
 - 18 i 貫通孔

- 18 j ディスク取り出し用窓み
- 18 k 係止部
- 18 l 係止部
- 18 m 貫通孔
- 18 n 貫通孔
- 19 ピックアップモジュール
- 19 a フレーム
- 19 b カバー
- 19 c 貫通孔
- 19 d 底板
- 19 e スピンドルモータ
- 19 f, 19 g シャフト
- 19 h 隆起部
- 19 i 取り付け部
- 19 j 防振用ダンパー
- 20 キャリッジ
- 20 a ガイド
- 20 b フレーム
- 20 c 反射ミラー
- 20 d コリメートレンズ
- 20 e プリズム
- 20 f 立ち上げプリズム
- 20 g 1/4 λ板
- 20 h 対物レンズ
- 20 i ディスク
- 20 j コリメートレンズ
- 20 k 積層プリズム
- 20 l センサ
- 20 m CD用半導体レーザ

21 モータ

21a ギヤ群

21b 回転シャフト

22 アクチュエータ

22a ダンパー

22b アクチュエータコイル

23 第1の回路基板

23a, 23b コネクタ

23c 第1の回路基板のピックアップモジュールに對面する一辺

24 第2の回路基板

24a 円弧状の切り欠き

24b, 24c, 24d, 24e コネクタ

24f 第2の回路基板のピックアップモジュールに對面する一辺

25 ソレノイド

26 カバー

26a カバー固定部

26b 貫通孔

26c 突出部分

27 結線手段

27a 折り曲げ部

27b 固定手段

28 ブレーキ

28a ケース

28b 可動部

28c パット

28d バネ

28e 移動軸

28f 傾斜面

28g ディスク

29 光ディスク装置固定部

29a ランド

29b 孔

29c ランド

29d 孔

30 係止用の爪

31 係止部

32 ドライブイジェクトスイッチ

33 可動ディスクカバー

A キャリッジの移動方向

B コネクタ23bの長辺の垂直二等分線

C コネクタ24bの長辺の垂直二等分線

D フレーム側部から突出したランドの近傍

E フレーム側部に入り込んだランドの近傍

F スピンドルモータ19eの中心からパット28c表面までの距離

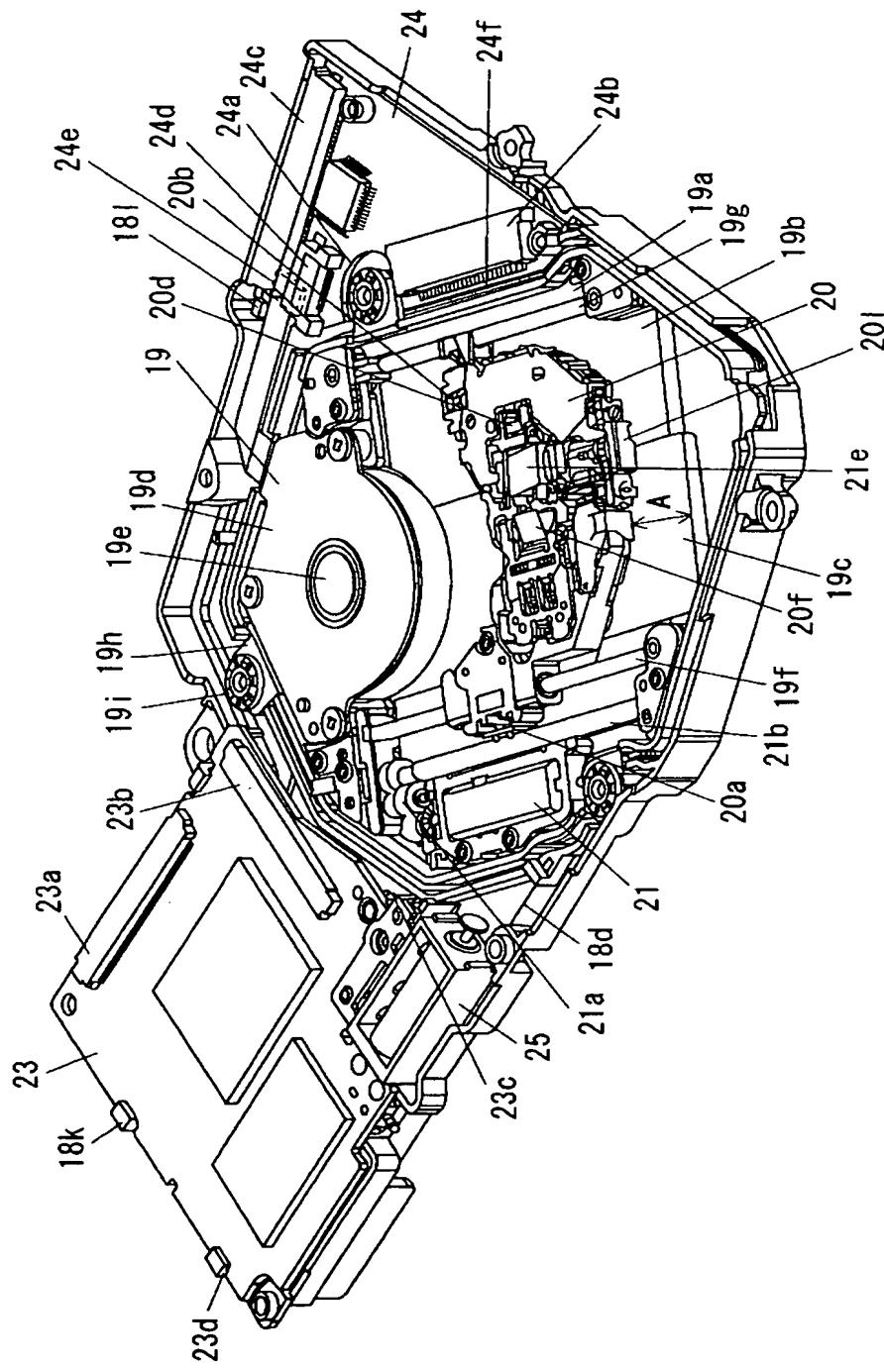
G パット28cのディスクの円周方向の寸法

H パット28cのディスク厚み方向の寸法

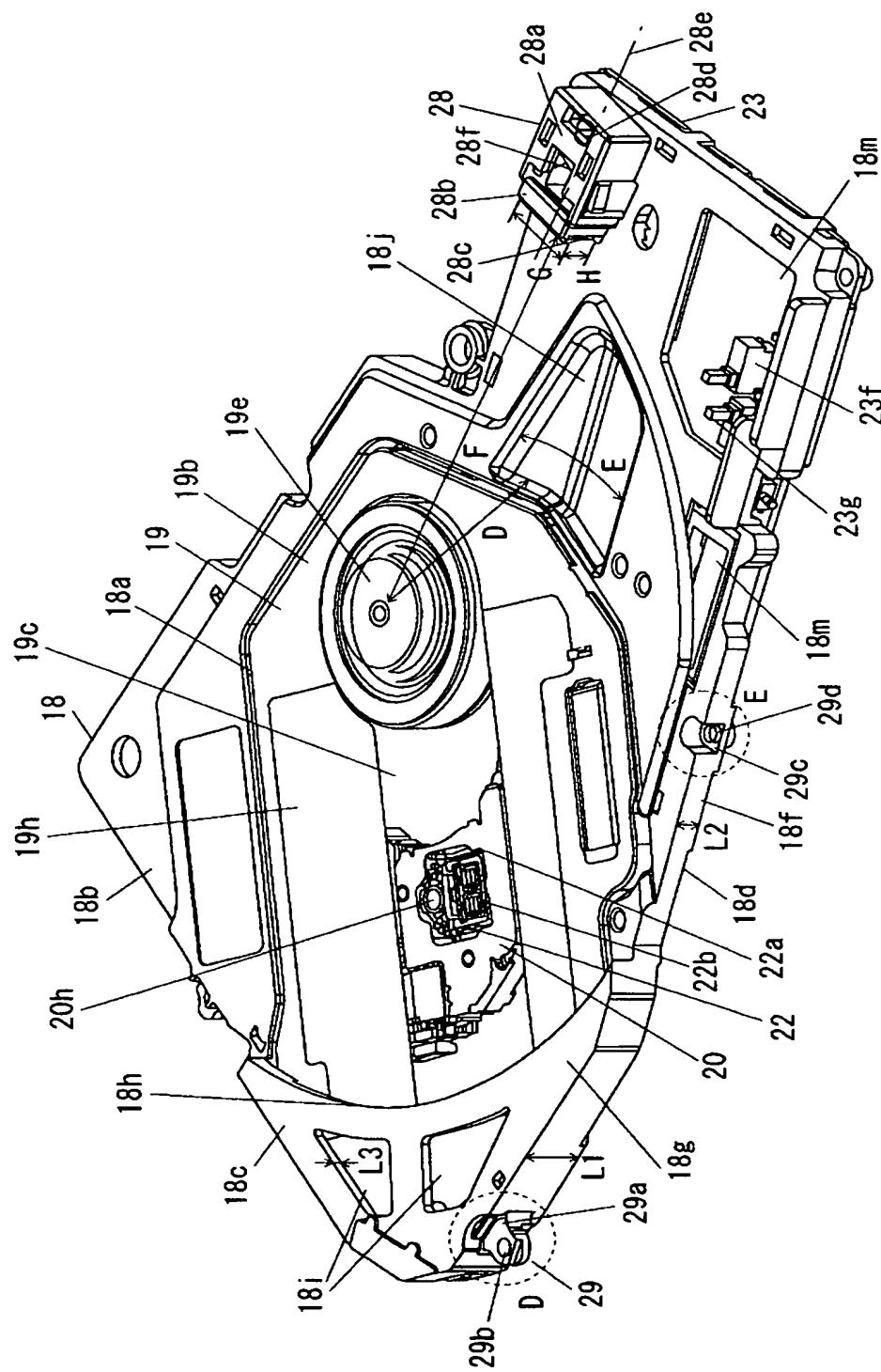
【書類名】

図面

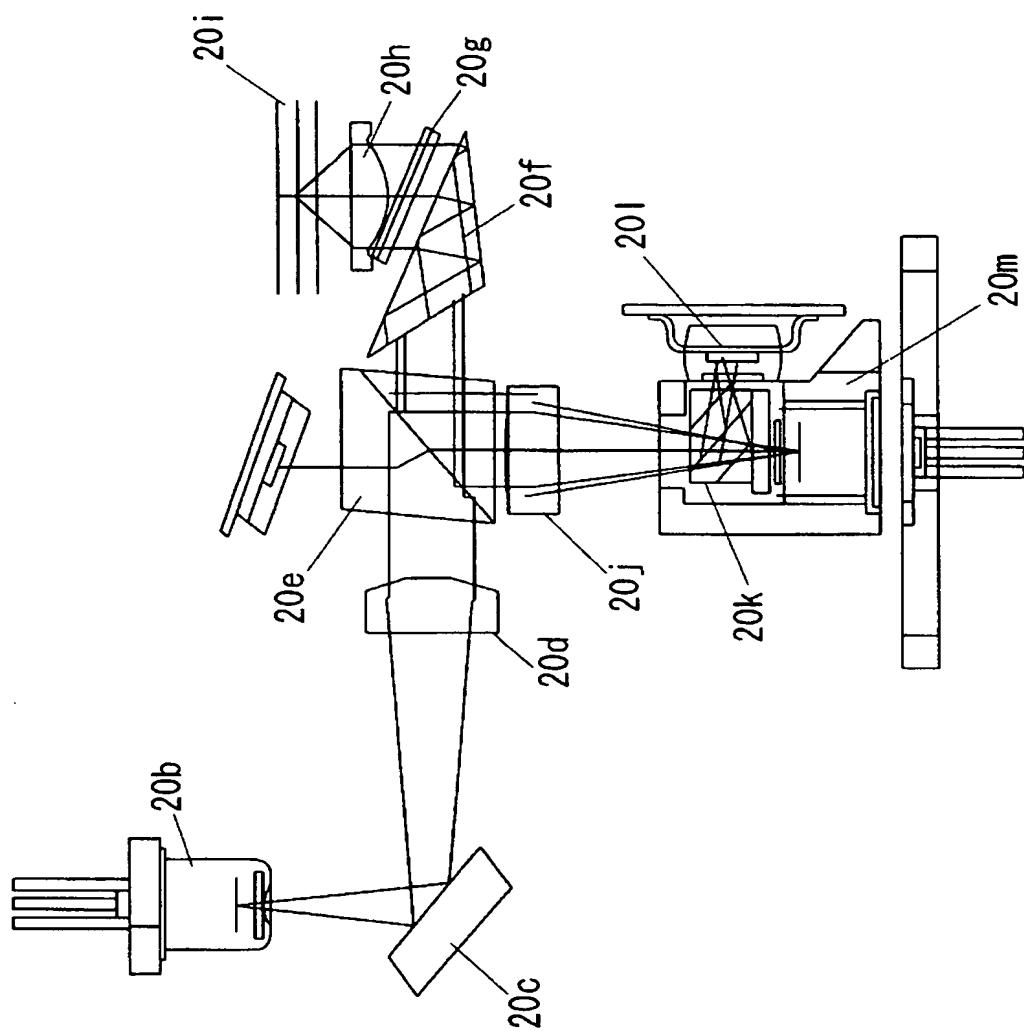
【図 1】



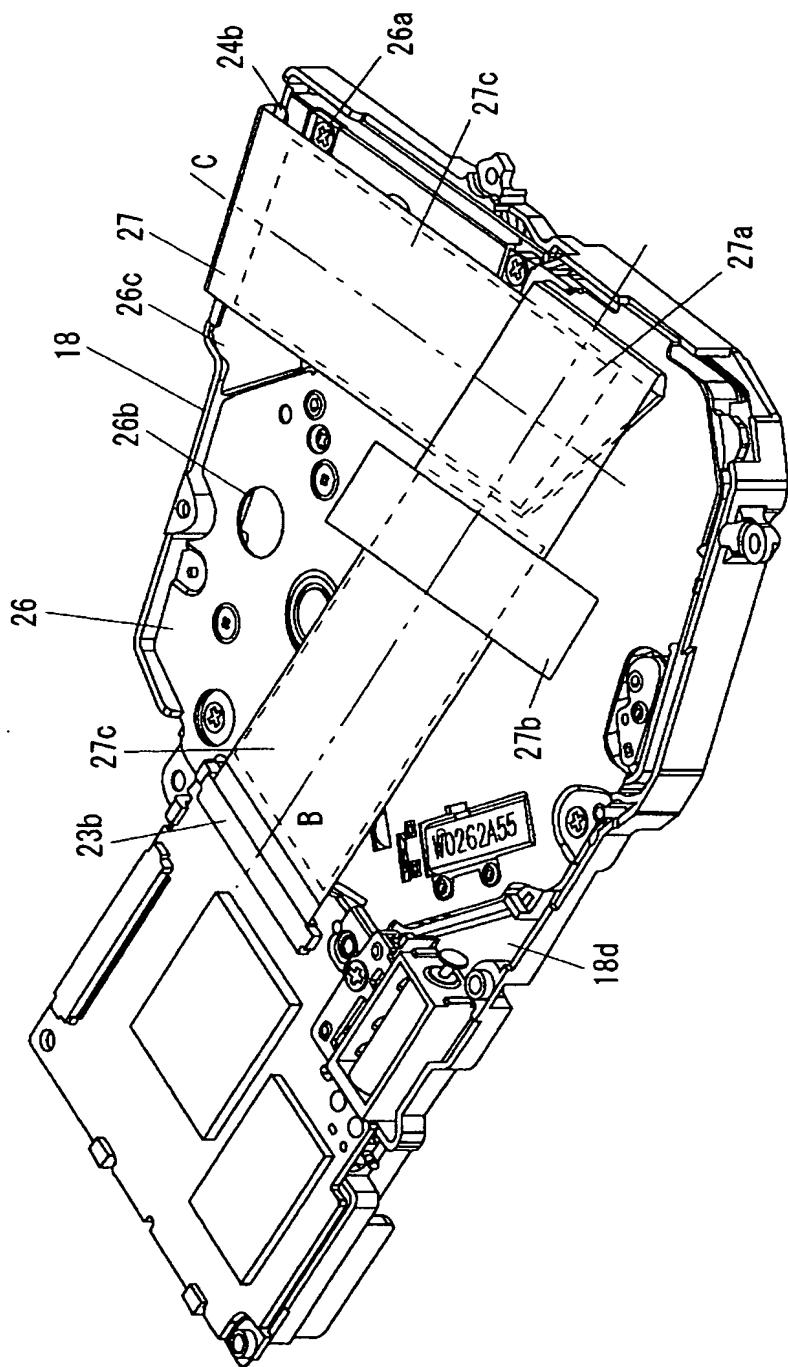
【図2】



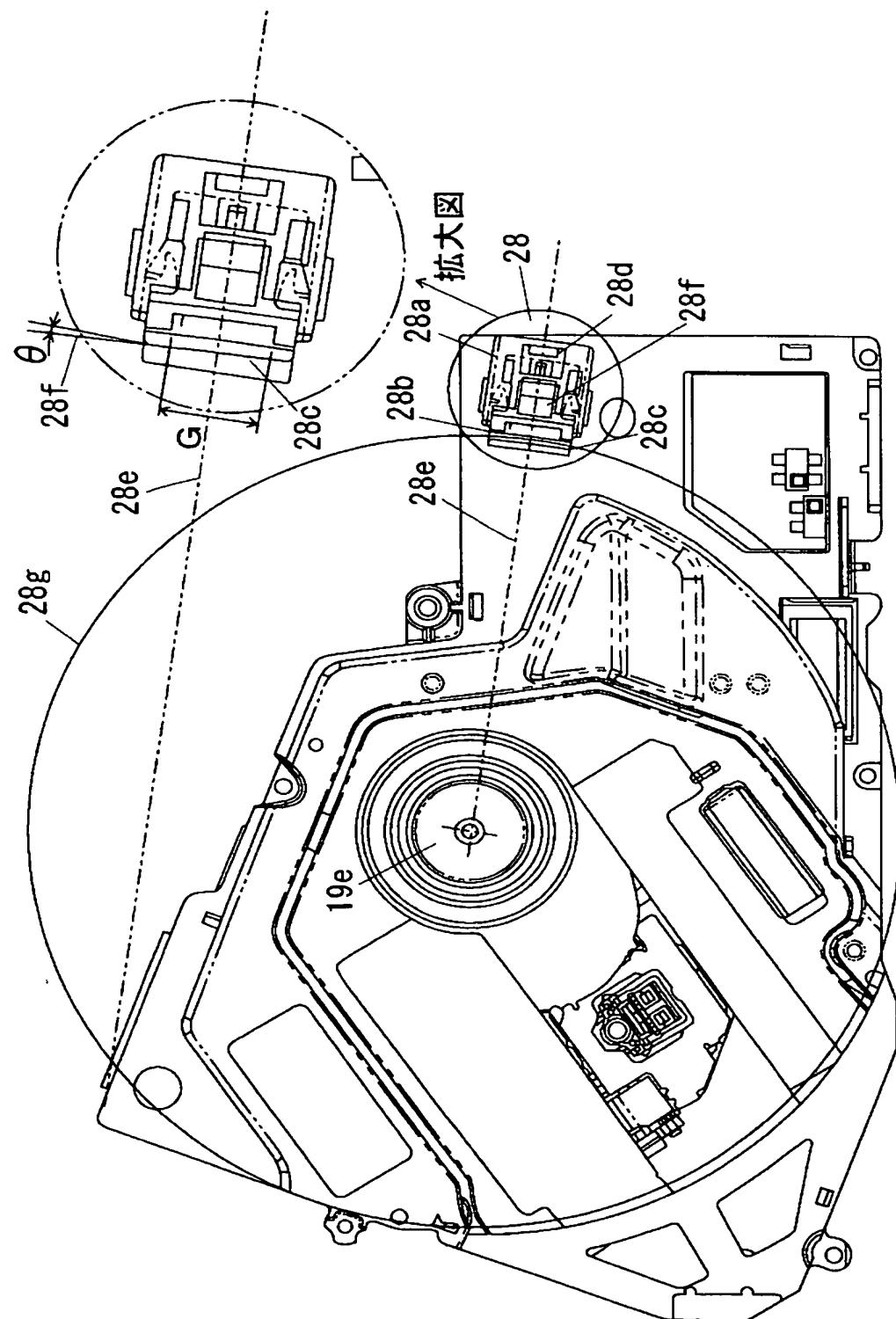
【図3】



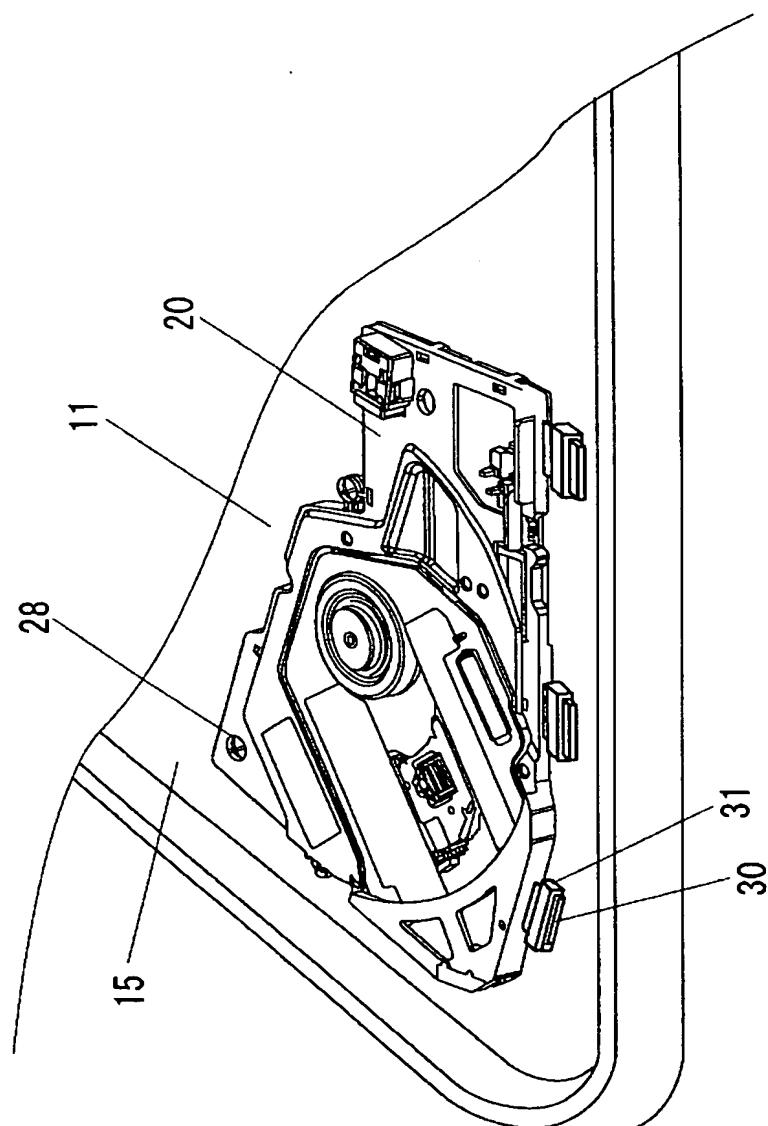
【図4】



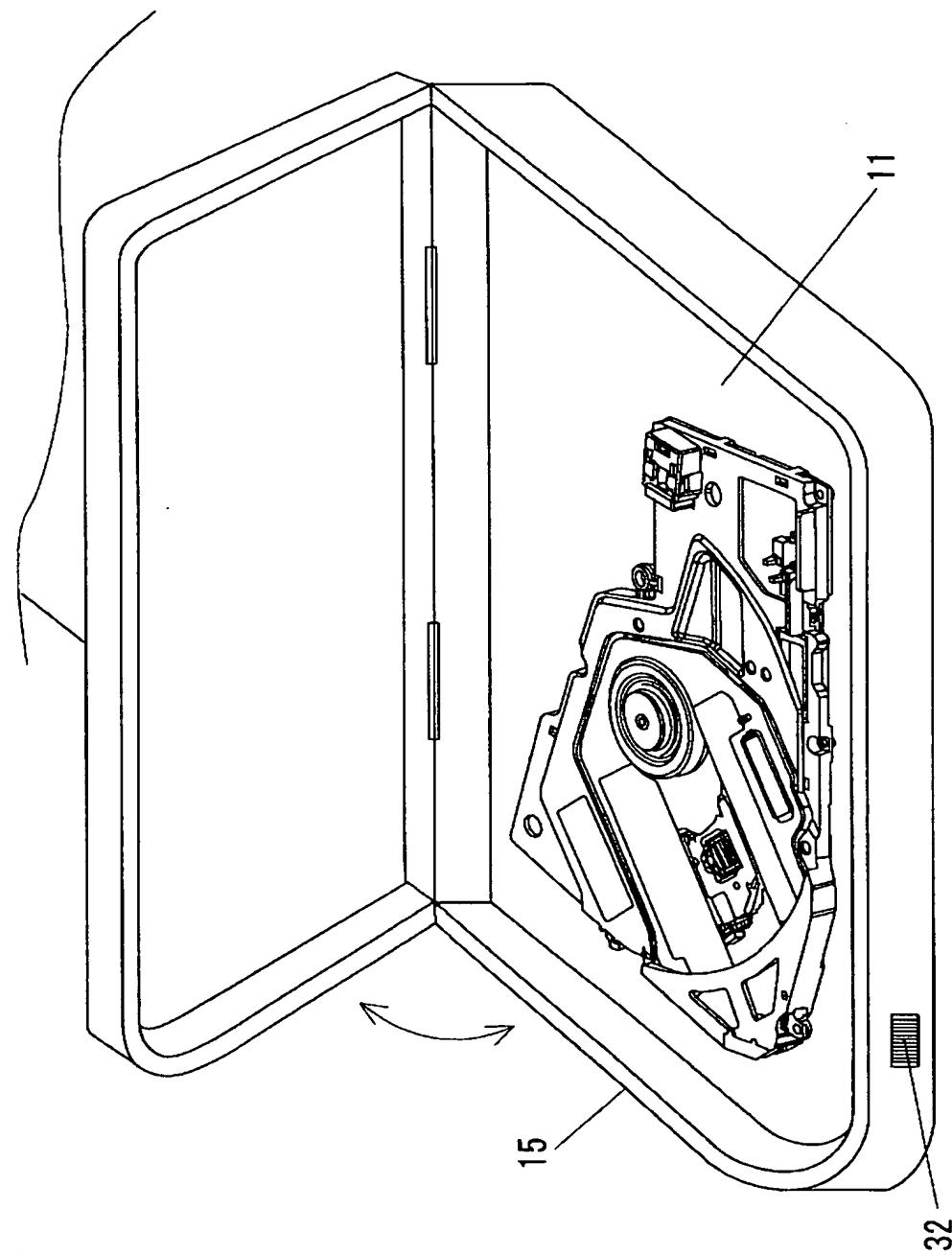
【図5】



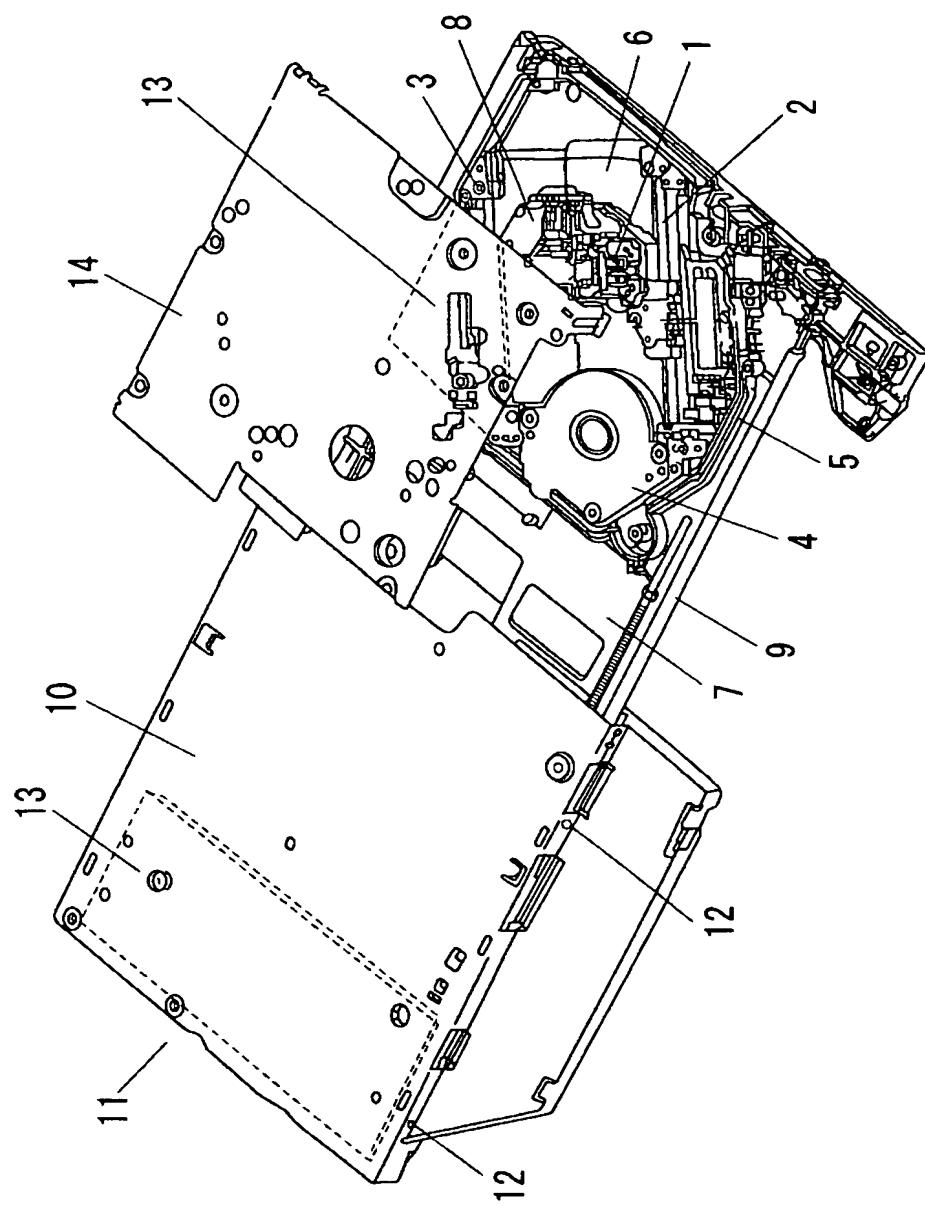
【図6】



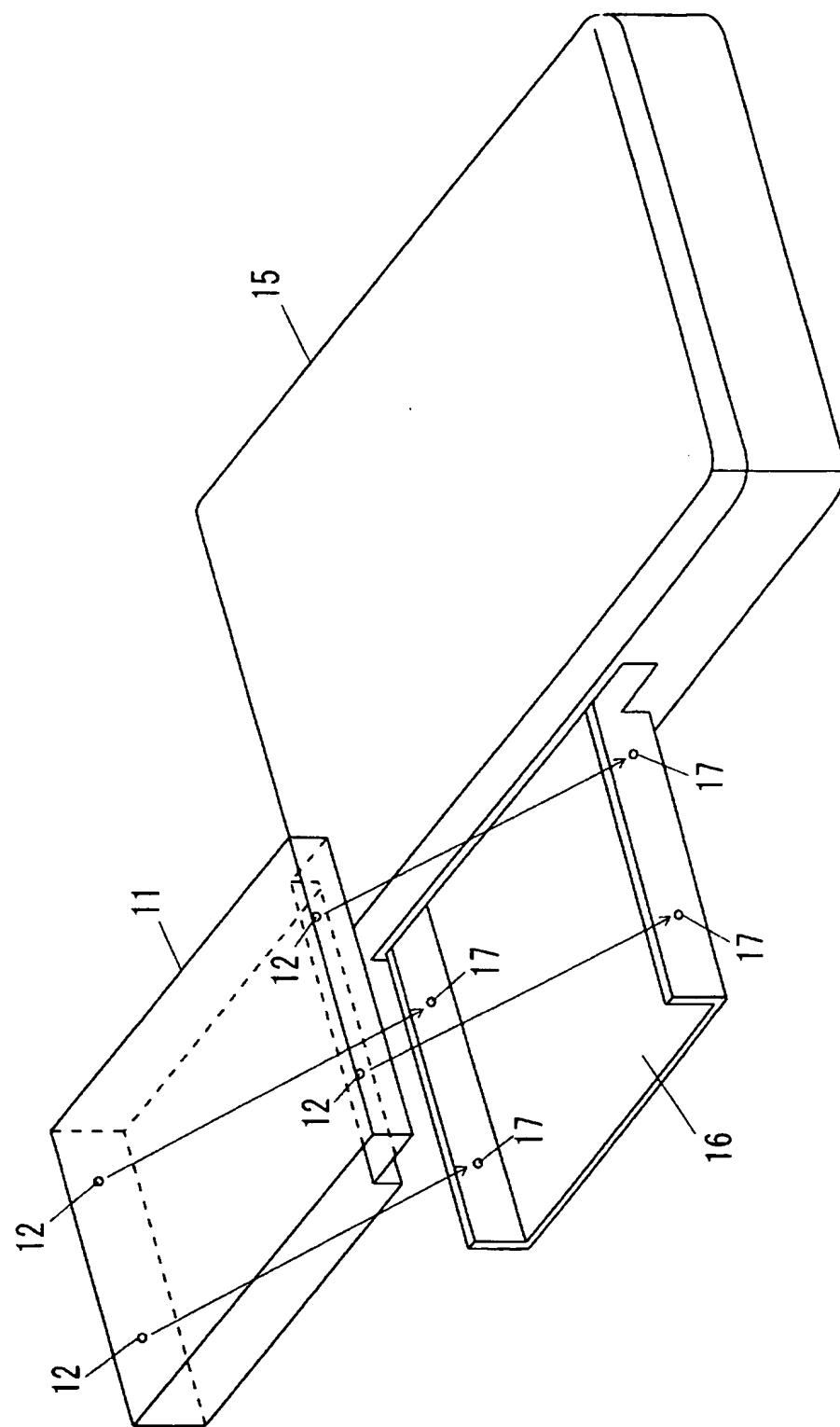
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 携帯用電子機器に薄型化や軽量化が求められる中、光ディスク装置における更なる薄型化、軽量化の要求が高いが、従来の構成では光ディスク装置を大幅に薄型、軽量にし、搭載する電子機器を薄型化、軽量化することは困難であった。

【解決手段】 フレームと、前記フレームに固定された光ピックアップモジュールと、前記フレームに固定された制御回路を形成する回路基板を備え、筐体を使用する事無しに光ディスク装置の構成部品を固定し、前記フレームは樹脂を含む材料で構成され、前記フレーム重量は13g以下であり、本体重量は140g以下とする。これによって光ディスク装置の大幅な薄型化、軽量化及び取り付け電子機器本体の薄型化、軽量化を達成する。

【選択図】 図1

特願 2003-115570

出願人履歴情報

識別番号 [000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住所 大阪府門真市大字門真1006番地
氏名 松下電器産業株式会社